

Fluon+™ ADHESIVEは、フッ素樹脂の持つ特徴をそのままに接着性を付与した製品群です。

■ 代表品種

スタンダードグレード

物性	Unit	LH-8000	AH-5000	AH-2000	AH-800	AH-700	EA-2000
MFR	g/10min	4	26	25	25	13	16
比重	-	1.75	1.76	1.78	1.73	1.73	2.13
融点	°C	190°C	225°C	245°C	255°C	258°C	300°C

導電グレード

物性	Unit	AH-600C	AH-3000L	AH-800C	AH-700C
MFR	g/10min	4	6.5	5.5	2
比重	-	1.76	1.77	1.75	1.75
融点	°C	230°C	240°C	255°C	258°C

■ パウダー

溶融加工時	推奨加工温度	EA-2000 PW10 ・平均粒子径：2~3μm	EA-2000 PW50 ・平均粒子径：20~50μm
300°C		IP10E, IP20E ・平均粒子径：10~50μm	
200°C		JBB-0001 ・平均粒子径：20~50μm	



■ 分散液 (Fluon+™ EA-2000)

	水系分散液	溶剤系分散液
平均粒子径 (d50) μm	< 3	< 3
粒径 (d90) μm	< 7	< 7
粘度 (60rpm) m Pa sec	20 ~ 300	20 ~ 2,000
パウダー容量 w t%	30 ~ 50	30 ~ 50
界面活性剤	フッ素系界面活性剤	フッ素系界面活性剤
界面活性剤濃度 w t% vs EA-2000powder	3 ~ 5	0 ~ 5
溶媒種	水	MEK, DMF, Toluene, Xylene, DMAC, NMP

■ LH-8000 2層積層体

特にPAエラストマーやエポキシ変性エチレンコポリマーとの
接着性に優れています。

2層構成
LH-8000
相手材

相手材	接着強度 (N/cm)	積層条件
PA12	18	プレス 220℃
PA エラストマー	44	プレス 220℃
ポリエステル系 TPU	26	プレス 220℃
エポキシ変性エチレンコポリマー	70	プレス 220℃
SUS304	10	プレス 240℃

■ EA-2000と銅箔との接着性

樹脂に特別な化学処理等の表面処理を施すことなく、

プロファイルフリー銅箔、及び無粗化銅箔との接着が可能です。

	表面粗度 (Rz)	密着力 (kN/m)
電解銅箔 (ED 箔)	1.2μm	>1.0
圧延銅箔 (RA 箔)	0.6μm	>1.0

